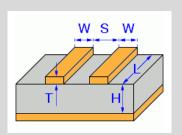
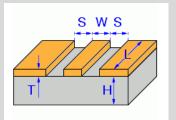
# IMPEDANCIA CONTROLADA EN CIRCUITOS IMPRESOS

Ing. Noelia Scotti (noeliascotti@gmail.com)

### Cuándo es necesaria?

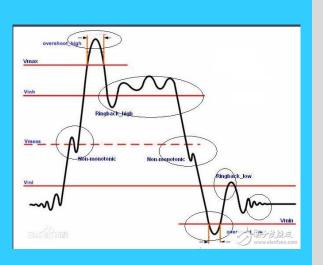
- Líneas de RF
- USB
- Ethernet
- HDMI
- SATA
- Memorias





### Qué tareas implica?

- Estudio del valor de impedancia necesario.
- Selección del stack-up.
- Cálculo del ancho de la pista para la impedancia requerida.
- Diseñar el PCB.
- Validar la impedancia.



### Qué pasa si no tenemos en cuenta la impedancia de las pistas?

A frecuencias altas, la variación de impedancia de un punto a otro provoca reflexiones y distorsiones en la señal.

Entonces hay que controlar la impedancia de las pistas!

Este es el primer paso para lograr lo que se llama SIGNAL INTEGRITY o integridad de señal.

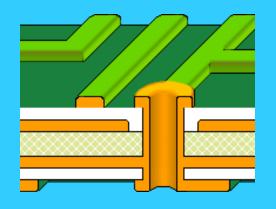
### DISEÑO DE STACK-UP



Definir planos de señal y de referencia.

El stack-up se define junto con el fabricante.

St	Stack-up de 4 layers (Nanya NY1140)					
		Layer	Espesor			
М	ásca	ra antisoldante	0,02 mm			
	Lī	Cobre 1 Oz	0,035 mm			
	Pre	preg 1x7628	0,19 mm			
	L2	Cobre ½ Oz	0,018 mm			
		CORE	1,18 mm			
	L3	Cobre ½ Oz	0,018 mm			
	Pre	preg 1x7628	0,19 mm			
	L4	Cobre 1 Oz	0,035 mm			
М	ásca	ra antisoldante	0,02 mm			
		Total	1,7 mm			



### STACK-UP - MATERIALES

### **Tipos de Materiales**

- Copper Foils
- Cores / Laminates
- Prepregs

### **Fabricantes**

- Isola
- Rogers
- Nouya



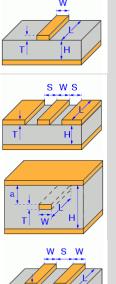


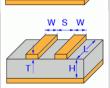


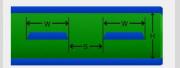
### LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

Microstrip

- Microstrip con plano adyacente
- **Stripline**
- Microstrip diferencial
- **Stripline diferencial**





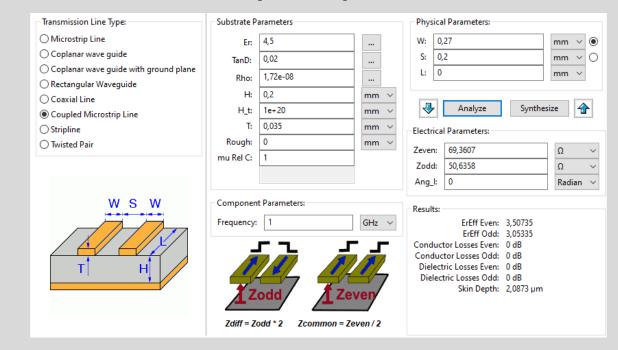


### SOFTWARE DE CÁLCULO

- KiCAD PCB Calculator
- Saturn PCB Design Inc.: PCB Toolkit
- Mentor Graphics: Hyperlynx
- Sierra Circuits: www.protoexpress.com/hdi/hdi-toolsimpedance-calculator.jsp
- Polar Instruments Software: Si9000

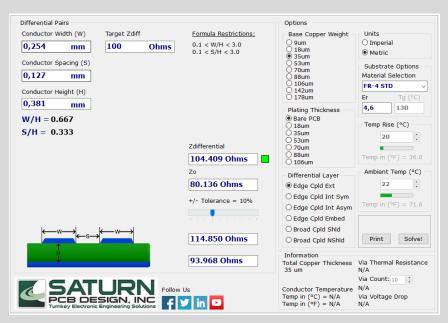
### SOFTWARE DE CÁLCULO

### PCB Calculator (KiCAD)



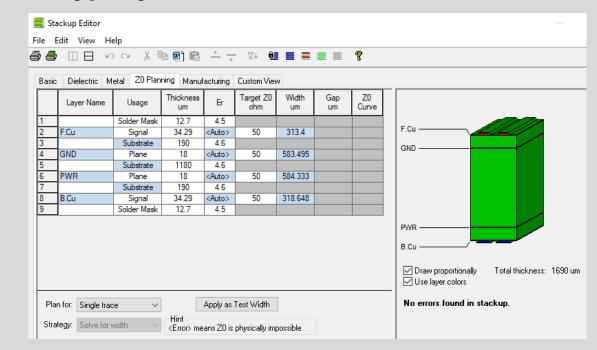
### SOFTWARE DE CÁLCULO

PCB Toolkit (Saturn PCB Design Inc.)



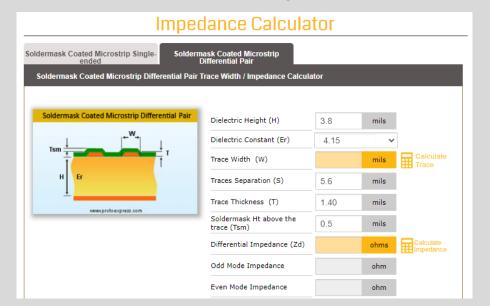
### SOFTWARE DE CÁLCULO

### Hyperlynx SI GHz



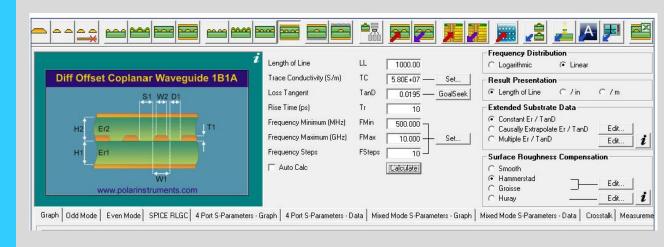
### SOFTWARE DE CÁLCULO

 www.protoexpress.com/hdi/hdi-toolsimpedance-calculator.jsp (Sierra Circuits)



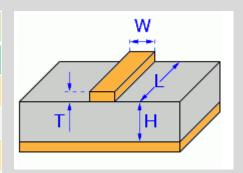
### SOFTWARE DE CÁLCULO

#### Polar Instruments SI9000



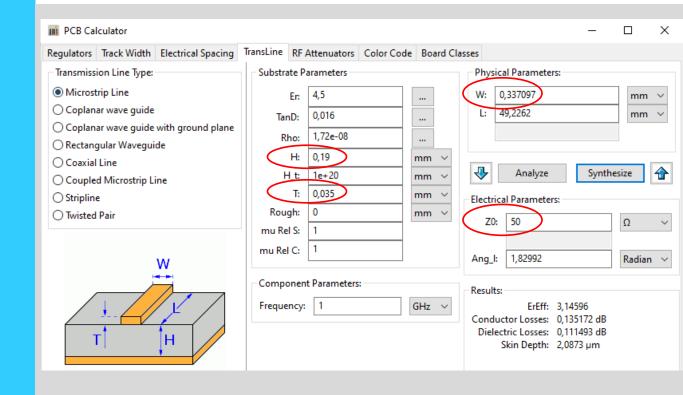
### EJEMPLO DE CÁLCULO MICROSTRIP 50 OHM

Stack-up de 4 layers (Nanya NY1140)					
Máscara antisoldante	0,02 mm				
L1 Cobre 1 Oz	0,035 mm				
Prepreg 1x7628	0,19 mm				
L2 Cobre ½ Oz	0,018 mm				
CORE	1,18 mm				
L3 Cobre ½ Oz	0,018 mm				
Prepreg 1x7628	0,19 mm				
L4 Cobre 1 Oz	0,035 mm				
Máscara antisoldante	0,02 mm				



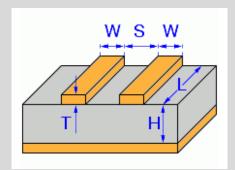
Pista Antena Zo = 50 ohm W?

### EJEMPLO DE CÁLCULO MICROSTRIP 50 OHM



### EJEMPLO DE CÁLCULO MICROSTRIP DIFERENCIAL

Stack-up de 4 layers (Nanya NY1140)					
Máscara antisoldante	0,02 mm				
L1 Cobre 1 Oz	0,035 mm				
Prepreg 1x7628	0,19 mm				
L2 Cobre ½ Oz	0,018 mm				
CORE	1,18 mm				
L3 Cobre ½ Oz	0,018 mm				
Prepreg 1x7628	0,19 mm				
L4 Cobre 1 Oz	0,035 mm				
Máscara antisoldante	0,02 mm				

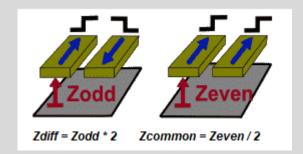




USB Zdiff = 90 ohm W?, S?

### IMPEDANCIA EN MODO DIFERENCIAL

Zdiff = Zodd \* 2



#### **Zodd: Impedancia impar**

Impedancia de una sola línea al aplicar señales con polaridad opuesta. Zodd = Zdiff/2.

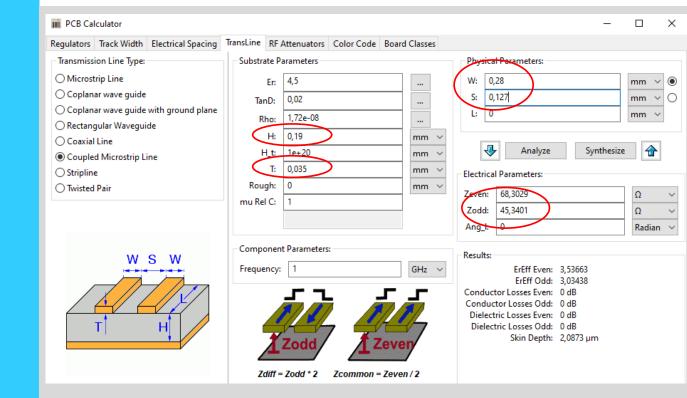
#### Zeven: Impedancia par

Impedancia de una sola línea al aplicar señales con la misma polaridad.

#### **Zdiff: Impedancia diferencial**

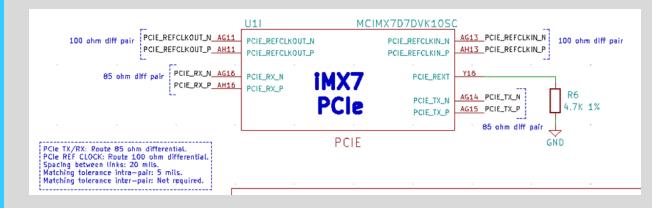
Impedancia entre las dos líneas con señales diferenciales aplicadas.

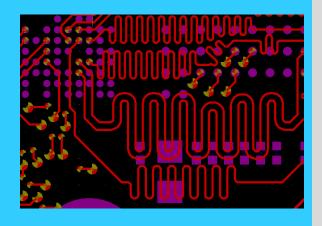
### EJEMPLO DE CÁLCULO MICROSTRIP DIFERENCIAL



### DISEÑO DE SCH

 Documentar en el esquemático las señales con impedancia controlada y las reglas de diseño.





### DISEÑO DE PCB

- Rutear con los anchos de pista calculados.
- Documentar el stack-up y los anchos de pista en una capa del PCB.

## STACK UP (doble prepreg) Top: 1 oz (Signal) L2: 1 oz (Plane) L3: 1 oz (Signal) Bot: 1 oz (Plane) Microstrip Line / Differential Microstrip Prepreg 2x 7628 Nanya NY1140: 0.38 mm Laminate NY1140: 0,80 mm Stripline / Edge Coupled Stripline Prepreg 2x 7628 Nanya NY1140: 0.38 mm Total aprox.: 1,7 mm

IMPEDANCE CONTROL
50 OHM TOP/BOT LAYER: 0.3 mm
50 OHM L2/L3 LAYER: 0.23 mm
90 OHM DIFF TOP/BOT LAYER: 0.25/0.2 mm
90 OHM DIFF L2/L3 LAYER: 0.18/0.2 mm
100 OHM DIFF TOP/BOT LAYER: 0.15/0.15 mm



### CUPONES DE TEST DE IMPEDANCIA

#### **OBJETIVO**

Medir con un TDR la impedancia de las diferentes líneas de transmisión para verificar valores teóricos calculados.

#### **QUÉ TIENEN LOS CUPONES?**

Microstrip 50 ohm Microstrip 75 ohm Diff. Microstrip 100 ohm NORMAS IPC IPC-2141A IPC-TM-650



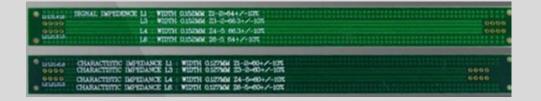


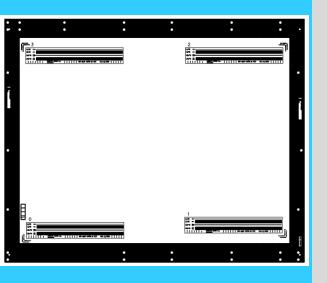
### MEDICIÓN DE IMPEDANCIA

EJEMPLO DE REPORTE DE MEDICIÓN

CUPONES DE TEST ENTREGADOS POR EL FABRICANTE

S	CC SHE	NNAN CII	股份有限公司 RCUITS CO.,LTD. 1pedan		asurem			文档密级: 内部公开 For Internal use only
物资编码/Material Coding:			101247339		零件号/Part	No:	000-L10-FR4-29	83-1111
生产号/Product No:			11-100614852-	1-01	日期/Date:		2019/3/18	
操作人/Operator:			杨彩红 审核人/Em			endator: 廖春英 / 施金花		E
NO.	Description	SPEC	+%	-%	Average	Result	Operator	Date
1	1.1	50	10	10	51.49	PASS	GSL	2019/3/11
1	L3	50	10	10	51.68	PASS	GSL	2019/3/11
1	1.4	50	10	10	50.47	PASS	GSL	2019/3/11
1	1.7	50	10	10	48.75	PASS	GSL.	2019/3/11
1	L8	50	10	10	52, 93	PASS	GSL	2019/3/11
1	L10	50	10	10	46. 26	PASS	GSL	2019/3/11
1	LI	85	10	10	84. 96	PASS	GSL.	2019/3/11
1	LI	90	10	10	92.73	PASS	GSL	2019/3/11
1	1.1	100	10	10	98.08	PASS	GSL	2019/3/11
1	L7	100	10	10	105.18	PASS	GSL	2019/3/11
1	L8	100	10	10	103.89	PASS	GSL	2019/3/11
1	L10	85	10	10	83, 14	PASS	GSL	2019/3/11
1	L3	100	10	10	104, 45	PASS	GSL	2019/3/11
1	L4	100	10	10	107, 30	PASS	GSL	2019/3/11
1	1.10	100	10	10	98, 51	PASS	GSL	2019/3/11
2	11	En.	1.0	4.0			000	





### CUPONES DE TEST DE IMPEDANCIA - DISEÑO

Si la fabricación será local, será necesario proveer al fabricante del diseño del cupón.

El fabricante coloca en su panel de fabricación un cupón en cada esquina.

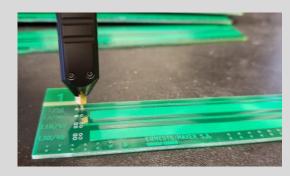




### TDR INTI: TEKTRONIX DSA8300

El equipo de INTI posee puntas single ended

y puntas diferenciales.



Punta Tektronix P8018 (1,8 mm)

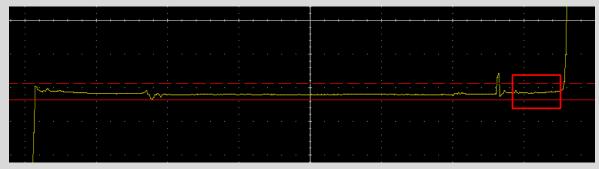


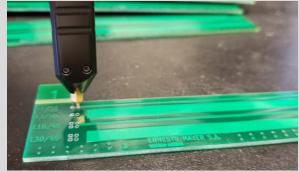
Punta Tektronix P80318 (0,5 mm a 4,2 mm)

5.14Z000e-000	5.Z19511e+001			
5.146000e-008				
5.150000e-008	5.144148e+001			
5.154000e-008	4 50304e+001	MIN	MAX	PROMEDIO
5.158000e-008	5.185450e+001	50,64322	51,8545	51,1430038
5.162000e-008	5.145067e+001			
5.166000e-008	5.178041e+001			
5.170000e-008	5.169243e+001			
5.174000e-008	5.107301e+001			
5.178000e-008	5.104255e+001			
5.182000e-008	5.156693e+001			
5.186000e-008	5.159581e+001			
5.190000e-008	5.113353e+001			
5.194000e-008	5.116575e+001			
5.198000e-008	5.096479e+001			
5.202000e-008	5.084716e+001			
5.206000e-008	5.078810e+001			
5.210000e-008	5.098250e+001			
5.214000e-008	5.101761e+001			
5.218000e-008	5.098829e+001			
5.222000e-008	5.108639e+001			

### MEDICIÓN DE IMPEDANCIA CON TDR

### Medición de líneas single ended

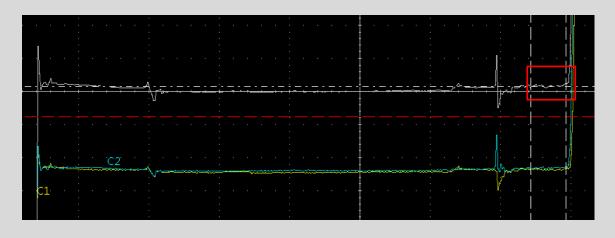






### MEDICIÓN DE IMPEDANCIA CON TDR

Medición de líneas diferenciales



Configurar en el equipo la suma de los dos canales: Zdiff = Zodd1 + Zodd2

### MEDICIÓN DE IMPEDANCIA CON TDR

Determinación de la zona de medición (según IPC-TM-650)

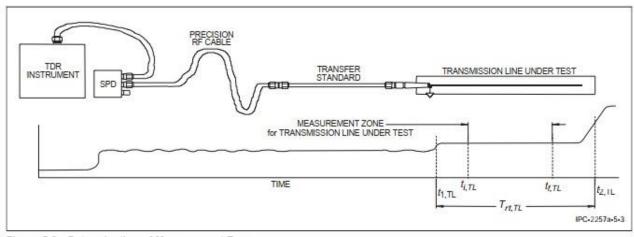
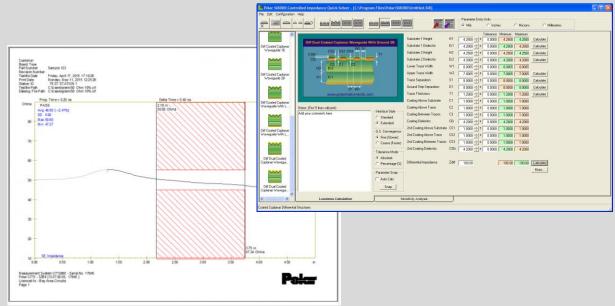


Figure 5-3 Determination of Measurement Zone



### MEDICIÓN EN FÁBRICAS -POLAR INSTRUMENTS

La mayoría de las fábricas de PCB usan el Software y el TDR de Polar Instruments.



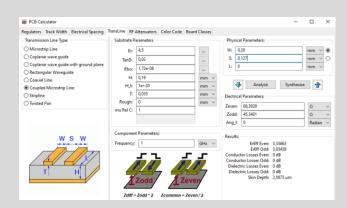


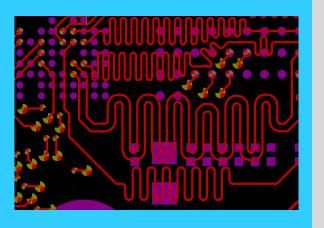
### CHECKLIST 1 - ESTUDIO

- Identificar las líneas que necesitan impedancia controlada.
- 2. Estudiar cada caso para saber el valor de impedancia y la tolerancia permitida.
  - a) Hojas de datos.
  - b) Notas de aplicación.
  - c) Libros o publicaciones.
  - d) Generalmente las líneas que necesitan IC también requieren de otras consideraciones relacionadas con signal integrity y ruteo.

### CHECKLIST 2 – CÁLCULOS

- Definir el stack-up
  - a) Cantidad de capas y cómo usarlas.
  - b) Materiales y espesores.
  - c) Dialogar con el fabricante del PCB.
- 2. Calcular el de ancho de las pistas utilizando un software especializado.



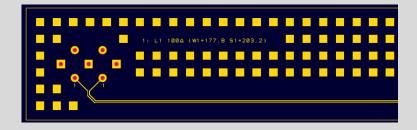


### CHECKLIST 3 – DISEÑO DE PCB

- 1. Documentar en el esquemático: Marcar las líneas con IC y colocar notas sobre las consideraciones especiales que necesitan dichas líneas.
- 2. Configurar los anchos de pistas necesarios, y la separación en el caso de pares diferenciales.
- 3. Rutear con los anchos de pista correspondientes (además de considerar todos los otros requerimientos de las líneas especiales).
- 4. Documentar el stack-up en una capa de documentación del PCB. También aclarar las duplas impedancia/ancho de pista que se desean en las capas de interés.

### CHECKLIST 4 – VERIFICACIONES

- 1. Simulación post-layout (antes de mandar a fabricar).
- 2. Verificación de la impedancia luego de la fabricación:
  - a) Solicitando el servicio de medición al fabricante.
  - b) Diseñando un cupón propio para luego medirlo.
  - c) Prueba funcional del circuito.



### MATERIAL DE LECTURA

- Libro de Eric Bogatin: Signal and Power Integrity - Simplified
- Web de Polar Instruments
- Guía de Impedancia Controlada de Sierra Circuits.
- Simulación de reflexiones en la web de Bogatin: VRPW-30-16





Autor: Ing. Noelia Scotti (noeliascotti@gmail.com)